

2021年 月 日現在

ふりがな					
氏 名					
生年月日	西暦	年	月	日	(満 歳) 男 ・ 女
携帯TEL	()	—			
E-mail	@				
現住所TEL	()	—			

写真を貼る位置

縦4cm×横3cm



ふりがな					
現住所	〒				
ふりがな					
休暇中住所	〒				
	TEL () —				

年(西暦)	月	学 歴	(高等学校卒業より記載、大学や院は学科・専攻まで記載)
20			
20			
20			
20			
20			
20			

希望受験地に○	神戸（本社）	／	東京（東京支店）
---------	--------	---	----------

研究課題（ゼミ等）	
-----------	--

大学・院での“学び”を通してどんな力が身に付きましたか。その力を当社でどう活かしていきたいですか。

--

今後、ますますロボット化やAIの導入が進むと思います。 先進技術と人が共存する工場にする為にはどのようなことが必要だと思いますか。
--

--

あなたの“将来の夢”を教えてください。

--

資格	
----	--

参加したインターンシップや説明会があれば記載して下さい	(インターンシップ： 月 日開催) (説明会： 月 日開催)
-----------------------------	--------------------------------

※見やすく丁寧に記載し、送付用封筒に希望受験地(神戸か東京)と希望職種(エンジニアリング)と記載して下さい